

USB3.0×7とCOM×4を装備し、コンパクト設計ながら優れたコストパフォーマンス

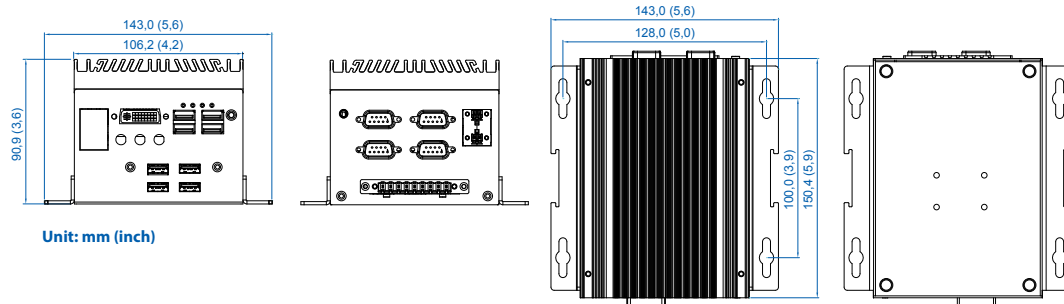
SPC-2900-LGN



- クアッドコア インテル® Celeron® プロセッサー J1900搭載
- コンパクト設計 W106mm × L150.4mm × H91mm (突起物等を除く)
- 最大-25°C~+70°Cの広温度対応
- USB3.0ポートを7基装備
- ギガビットLANポートを2基装備
- COMポートを4基装備
- 6V~36V DC-in
- 絶縁型8 DIO (4 DI, 4 DO) 装備



■ 外観寸法



■ 製品仕様

プロセッサ	種類	インテル® Celeron® プロセッサ J1900 (4コア、2M Cache、2.00 GHz)
	搭載数	1
チップセット		インテル® SoC
メモリー	規格	DDR3L 1333MHz SO-DIMM
	容量	最大8GB
	スロット数	1
ストレージ		1 (SSD/HDD)
グラフィックス		インテル® HD グラフィックス
I/O	シリアル (COM)	4
	USB	7 (USB 3.0)、1 (USB 2.0)
	DIO	絶縁型8 (DIO : 4 DI、4 DO)
	DVI-I	1 (最大1920 × 1080)
	Ethernet	LAN 1 : Gigabit LAN, インテル® I210 LAN 2 : Gigabit LAN, インテル® I210
オーディオ	コーデック	Realtek ALC892, 5.1 Channel HD Audio
	端子	1 Line-out
電源	電源入力	6V~36V、DC-in
	電源入力タイプ	2-pin Terminal Block : V+, V-
	リモートスイッチ	2-pin Terminal Block : On, Off
外観寸法 (W × L × H)		106mm × 150.4mm × 91mm (突起物等を除く)
重量		約1.6kg
取付方法		ウォールマウント用ブラケット、DIN レール (オプション)
利用環境	動作温度	-25°C ~ +70°C
	保存温度	-40°C ~ +85°C
	湿度	5%~95% RH (結露なきこと)
	耐衝撃性	IEC 60068-2-27, SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms
	耐振動性	IEC 60068-2-64, SSD : 5Grms, 5Hz ~ 500Hz, 3 Axis
EMC指令		CE, FCC, EN 50155, EN 50121-3-2



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
TEL : 03-5446-5535 / hpcs_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viivロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Incの商標です。Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
2018年1月18日現在の内容です。